



Автоматическая установка монтажа шариков припоя SB²-SM



Являясь более дешевой версией SB²-Jet, но обладая такими же возможностями по точности монтажа, установка SB²-SM представляет собой систему последовательного монтажа и лазерного оплавления шариков припоя. Установка может работать как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режимах. Несмотря на относительно компактные размеры, установка SB²-SM обладает большим рабочим полем, чем SB²-M. Идеально подходит для проведения НИОКР, прототипирования и мелкосерийного производства.

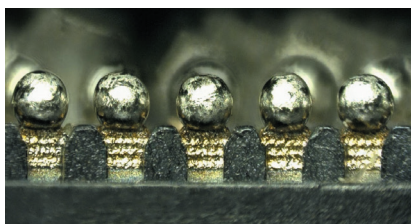
Основные возможности:

- Бесконтактный монтаж шариков припоя
- Материалы припоя – SnAgCu, SnAg, SnPb, AuSn, InSn, SnBi
- Бесфлюсовая пайка методом лазерного оплавления
- Диаметр шариков припоя от 60 до 760 мкм
- Функция ремонта (снятие шариков и реболлинг)



Возможные применения:

- Бампинг пластин или одиночных кристаллов
- Корпусирование на уровне пластин (Wafer Level CSP)
- Монтаж шариков припоя на корпуса BGA / CLCC, реболлинг
- Бесконтактная лазерная пайка компонентов на печатных платах
- Корпусирование MEMS и компонентов по технологии 3D
- Производство жестких дисков (HGA, HSA, Hook-Up, Spindle-motor)
- Сборка видеокамер, CMOS-датчиков
- Сборка изделий оптоэлектроники и микрооптических приборов
- Производство фильтров (SAW, BAW, F-BAR)



Параметры	SB ² -SM
Габариты / Рабочая зона	1183 x 880 x 1893 мм / 200 x 200 мм
Скорость и точность монтажа шариков	3–5 шар/сек; ± 5 мкм, 1 σ
Диаметр шариков	≥ 60 мкм
Рабочая станция	Стол для пластин
Автоматизация	Нет
Лазерная ручная центровка / Лазерная автоматическая центровка	Есть / Опция
Распознавание образов	Опция
2D / 3D пайка	Есть / Нет
Ремонт	Опция
Виды изделий	Части пластин, пластины диаметром до 8", подложки, одиночные кристаллы, корпуса BGA и CSP

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

*Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники*